

SURFIN

Polishing Pad



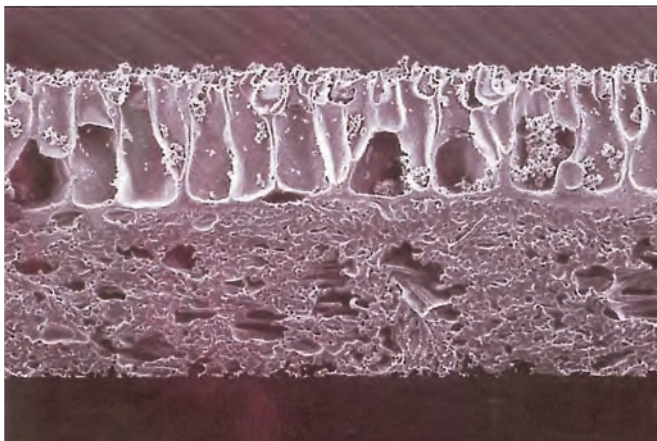
この写真はイメージです。This photograph is an image.

SURFIN

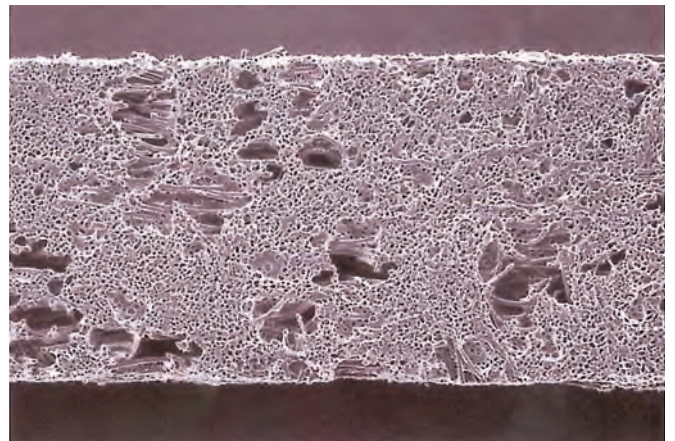
SURFINは、シリコンウェーファーをはじめあらゆる半導体結晶材料、および金属、ガラス等の高精度研磨に適したポリシング用パッドです。スクラッチフリー、ダメージフリーで欠陥のない超精密仕上げ面を作り出せるようデザインされており、用途に合わせて各種タイプをご用意しています。ご利用に際しては、ご希望のサイズにカットされた製品かロール製品が選べるほか、マシンへの貼付け作業が便利のように裏面にマウンティング用の両面接着フィルムを付けたタイプもご用意できます。

SURFIN

SURFIN is polishing pads ideal for high-precision polishing of all types of semiconductor crystal materials, including silicon wafers, as well as metals and glass. SURFIN has been designed to produce, a superfine polished surface which is scratch-free, damage-free, and without defects of any kind. From the many types of polishing pads available, a suitable one can be selected for each job. The polishing pad can be chosen in the form of a roll or made-to-order sizes are available. The product can also be ordered with a double-sided adhesive film attached to the back of the pad, for quick and easy installation.



スウェードタイプ断面形状写真
Suede type Cross sectional view



不織布タイプ断面形状写真
Non woven fabric type Cross sectional view

ポリシングパッド、サーフィン仕様 Specifications of SURFIN

項目 Item 品名 Product name	種類 Type	物性代表値 Typical data of physical properties				最大幅(mm) Max width (mm)	用途 Applications
		厚さ Thickness(μm)		硬度(°) Hardness(Å) (Shore-A)	開口径(μm) Pore size(μm)		
		総厚 Total thickness	ナップ層 Nap layer				
SURFIN XXX-5	不織布タイプ Non-woven	1,310	—	64	—	1,400	GaAs・InP(First polishing) LT, LN
SURFIN 018-3	スウェードタイプ Suede	1,385	46.4	68	83	1,480	Hard Disk, Si(Second polishing)
SURFIN 000	スウェードタイプ Suede	1,377	44.8	65	68	1,480	Si(Final polishing), Glass
SURFIN SS-W-1	スウェードタイプ Suede	1,483	54.4	57	67	1,480	Discontinued (Replaced by SSW-2)
SURFIN SS-W-2	スウェードタイプ Suede	1390~1610	420~640	49~61	48~92	1,480	Si・GaAs・InP(Final polishing)
SURFIN 191	スウェードタイプ Suede	1,140	51.0	43	55	1,000	GaAs・InP(Final polishing) Gap

■SURFIN XXX-5

SURFIN XXX-5は、Si、GaAs等の半導体ウェーファーストックリムーバル用として開発された不織布タイプの硬質ポリシングパッドです。中圧および高圧でのポリシングパッドとして、圧縮特性、空孔率が最適に組み合わされています。また、目詰まりが少なく、研磨ウェーファアの平坦度を維持しながら高能率で研磨することが可能、そのうえLife特性も優れています。

■SURFIN 018-3

SURFIN 018-3は、発泡ポリウレタンのスウェードタイプのポリシングパッドです。特殊処理により研磨の立ち上がりが良く、耐酸・耐アルカリ性に優れており、安定した研磨能率、研磨面が得られます。また、アルミ、ニッケル等の各種金属ディスク研磨にも優れており、オレンジピール等の表面欠陥のない高品質な研磨面が得られます。

■SURFIN 000

SURFIN 000は、ファイナル・ポリシング用として開発されたポリシングパッドです。ポリウレタン発泡層が非常に軟らかく、かつ微細多孔質であるため、ヘイズおよびスパイクフリーの高品質研磨面が得られます。

■SURFIN SSW-1

SURFIN SSW-1は、SURFIN 000の立ち上げ時間改善タイプとして開発された、スウェードタイプのポリシングパッドです。SURFIN 000と異なるポリウレタンを採用し、ナップ長を長くしたことにより、より短時間での立ち上げが可能です。シリコンウェーファア、GaAs、InP等のファイナルポリシングでヘイズフリーの高品質面が得られます。

■SURFIN 191

SURFIN 191は、特にGaAsおよびSi用として開発されたファイナルポリシングパッドで、ヘイズフリーの高品質面が得られます。また、SURFIN 191は発泡層と基布を接着法で加工しているため、従来のダイレクト製法に比べて品質の安定性が優れています。

■SURFIN XXX-5

SURFIN XXX-5, is a non woven hard fabric type polishing pad, developed for use in the stock removal of GaAs and other semiconductor wafers. For use under medium pressure or high pressure, this type of polishing pad has an ideal combination of compression and the proper proportion of porous characteristics. Due to these characteristics, there is less loading. This makes it possible to maintain the surface flatness of the wafer being polished and results in high precision polishing. Further, this product exhibits excellent long lasting properties.

■SURFIN 018-3

SURFIN 018-3 is a foam suede type polishing pad. Because it is specially treated, it has a quick startup and is able to withstand acidity and alkalinity, resulting in a consistent, effective polishing action and evenly polished surfaces. It is excellent for polishing various metal disks, such as aluminium and nickel, and provides a high quality polished surface free from damage, orange peel and other defects.

■SURFIN 000

The SURFIN 000 polishing pad was developed for use in final polishing. Because the polyurethane nap layer is extremely soft and is microporous, this polishing pad is able to produce a high quality polished surface which is free from haze or spikes.

■SURFIN SSW-1

SURFIN SSW-1 is a suede type-polishing pad developed to improve the breaking-in time performance compared to SURFIN 000. Shorter breaking-in time is achieved by using a different type of polyurethane and increased the nap length. Superior quality surface is available at the final polishing process of silicon wafer, GaAs, and InP.

■SURFIN 191

SURFIN 191 is a final polishing pad developed for use with GaAs and Si in particular, and produces a high quality, haze-free surface. The foam layer and base cloth of the SURFIN 191 are bonded together with adhesive, resulting in remarkable improvement in the consistency of quality in comparison with conventional pads produced by other methods. As the material used in the base cloth as well as its thickness can be changed, this product is able to meet wide range of polishing condition.